

格科微有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

格科微有限公司（以下简称“格科微”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《格科微有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”）。

除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《格科微有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同。

一、公司的主营业务

公司为国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为 CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、制造、封测和销售。公司目前主要提供 QVGA（8 万像素）至 5,000 万像素的 CMOS 图像传感器和 LCD DDIC/TDDI（分辨率涵盖从 QQVGA 到 FHD+）以及 AMOLED 穿戴类显示驱动 IC，其产品主要应用于手机领域，同时广泛应用于包括平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等在内的消费电子和工业应用领域。

公司在 CMOS 图像传感器领域和显示驱动领域深耕多年，拥有业内领先的工艺研发和电路设计实力。凭借优异的产品质量与性价比、高效的服务与技术支持、强大的供应链垂直整合能力，公司累积了深厚的客户资源。目前，公司已成为国内领先、国际知名的 CMOS 图像传感器和显示驱动芯片供应商。

二、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 420,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用本次募集资金投资金额
1	12 英寸 CIS 集成电路特色工艺扩产项目	613,200.74	300,000.00
2	高性能高像素图像传感器研发及产业化项目	57,666.44	50,000.00
3	补充流动资金	70,000.00	70,000.00
合计		740,867.18	420,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

三、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析

（一）12 英寸 CIS 集成电路特色工艺扩产项目

1、项目基本情况

本项目总投资为 613,200.74 万元，建设期为 3 年。本项目依托公司在图像传感器电路设计、像素设计、结构设计及工艺开发等方面的技术积累和产业化经验，基于现有 12 英寸 CIS 研发及晶圆制造平台，开展产线建设。项目通过购置相关软硬件设备、优化生产工艺和制造流程，新增月产 1 万片 CIS 图像传感器产品的生产能力，提升公司高性能 CIS 规模化制造及工艺平台支撑能力。

项目建成后，一方面将进一步完善公司自主知识产权及特色工艺体系，加强产品设计与生产制造协同，提升生产效率和良率，强化成本控制，进一步增强公司高端 CIS 产品的产业化能力；另一方面，新增产能将为公司高像素、高性能 CIS 产品的市场拓展提供制造保障，推动公司产品结构升级和业务规模扩大。此外，本项目的实施有助于提高国内高端 CIS 关键工艺及规模化量产能力，强化产业链自主可控水平，并带动相关上下游产业协同发展。

2、项目实施的必要性分析

（1）本项目是提升 CIS 国产化率，保障供应链自主可控的必要举措

CMOS 图像传感器（CIS）是实现图像采集和视觉感知的核心半导体器件，广泛应用于智能手机、汽车电子、安防监控、AR/VR 等领域。作为终端设备实现智能感知的重要基础器件，CIS 产业链自主可控水平对于提升半导体产业供应链韧性具有重要意义。

目前，全球 CIS 市场竞争格局较为集中，索尼、三星等海外厂商凭借长期技术积累和产业链布局，在高端 CIS 领域保持较强竞争优势，特别是在智能手机主摄等高端应用场景，在像素技术、BSI 及堆叠式架构、制造工艺等方面形成了较深技术积累。相较之下，国内 CIS 产业起步相对较晚，在部分高端产品设计能力及关键工艺环节与国际领先水平仍存在一定差距，高端 CIS 产品国产化水平仍有进一步提升空间。

在 CIS 晶圆制造环节，索尼、三星等厂商以自有晶圆制造能力为主，通过设计与制造协同推进产品迭代；台积电等专业晶圆代工厂依托先进逻辑制程及晶圆堆叠技术，为高端 CIS 产品提供制造支持。与此同时，国内晶圆制造企业已在成熟制程及特色工艺领域形成一定制造基础，但在高端 CIS 所需的先进堆叠工艺、逻辑层制造及设计制造协同等方面仍存在提升空间。

本项目通过进一步完善 CIS 晶圆制造及关键工艺布局，有利于提升高端 CIS 关键制造环节的国产化水平，增强公司供应链保障能力及产业链协同能力，推动国内 CIS 产业链进一步完善。

（2）本项目是持续推进产品结构升级，提升高端 CIS 市场竞争力的必要举措

随着智能手机影像功能持续向高像素、高动态范围、低照度及智能化方向升级，以及智能驾驶、智能座舱等汽车电子应用不断发展，终端客户对 CIS 产品性能、可靠性及集成能力提出更高要求，高性能 CIS 产品已成为行业技术升级的重要方向。相较于传统 CIS 产品，高像素、高动态范围及车规级 CIS 产品对像素工

艺、电路设计、制造精度及可靠性控制能力提出更高要求，需要持续提升工艺平台能力，以满足不同应用场景下产品性能提升需求。

近年来，公司持续推进高性能 CIS 产品研发及产业化，已形成覆盖 1,300 万、3,200 万、5,000 万像素等规格的产品体系，并实现多款高像素产品量产及客户导入。随着公司持续推进高像素、高性能产品布局，以及汽车电子等新兴应用领域拓展，公司需要进一步提升工艺平台适配能力和设计制造协同水平，以支撑新产品开发及产业化应用。

本项目通过工艺优化、设备配置及生产流程完善，提升公司 CIS 产品制造能力和工艺稳定性，有利于加快新产品产业化进程，推动产品结构持续优化，增强公司市场竞争能力。

(3) 本项目是扩大 CIS 产能规模，匹配业务增长并巩固市场竞争优势的必要举措

近年来，随着智能手机、汽车电子及安防监控等应用领域持续发展，CIS 产品应用场景不断拓展，市场需求持续增长。在智能手机领域，多摄配置及影像功能升级推动 CIS 产品需求提升；在汽车电子领域，ADAS、智能座舱、环视系统等应用逐步普及，车载摄像头搭载数量不断增加；在安防领域，高清化、智能化趋势推动监控设备持续升级，进一步拓展 CIS 应用空间。下游应用领域的发展对 CIS 制造企业的规模化生产能力和供应保障能力提出了更高要求。

随着下游市场需求增长以及公司业务规模持续扩大，公司现有制造能力需要进一步提升，以满足未来产品交付和市场拓展需求。本项目拟建设月产能 1 万片 CIS 生产线，进一步提升公司 CIS 产品规模化量产能力。

同时，本项目实施有助于公司进一步优化生产流程，提高产线利用效率，加强对生产过程、产品质量及制造成本的管理。通过自建关键制造环节，公司能够降低外部制造资源波动带来的影响，提高供应稳定性，并通过规模化生产和工艺优化提升产品成本竞争力。

综上所述，本项目实施有利于提升公司 CIS 产品规模化生产能力，增强客户

供应保障能力，满足公司业务持续发展需求，并进一步提升市场竞争优势。因此，本项目实施具有必要性。

3、项目实施的可行性分析

(1) 国家积极推动集成电路产业链发展，为本项目提供政策支撑

集成电路产业是支撑经济社会数字化转型、保障产业链供应链安全的重要基础性、战略性产业，长期以来受到国家及地方政府的高度重视。近年来，国家围绕集成电路产业技术创新、产业升级及自主可控持续出台一系列支持政策，为行业长期健康发展营造了良好的政策环境。

2026 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026-2030 年）》正式发布，进一步强化集成电路等战略性新兴产业的培育和发展，并围绕提升产业链供应链韧性和安全水平，对设计、制造、封装测试、设备、材料及核心零部件等产业链关键环节作出系统部署，提出持续推进关键核心技术攻关，加快补齐产业链短板，提升产业基础高级化和产业链现代化水平，增强产业链自主可控能力。在税收支持方面，2026 年 4 月，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等部门发布《关于做好 2026 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》，延续对符合条件的集成电路生产企业、集成电路设计企业及相关项目的税收优惠政策，进一步支持集成电路产业研发创新、产能建设及产业化发展。一系列政策的陆续出台为本项目提供了政策支撑。

(2) 丰富的技术储备和良好的工艺研发能力，为本项目提供技术支持

自成立以来，公司始终重视工艺研发和产品设计创新，已形成覆盖像素工艺、电路设计、高像素单芯片集成及先进封装等领域的核心技术体系。在工艺研发方面，公司通过优化 Pixel 工艺、减少光罩层数等方式，在保障产品性能的同时有效降低生产成本，并持续推进 Galaxy Cell®工艺平台升级。2025 年，公司 Galaxy Cell® 2.0 工艺平台进一步集成 FPPI® Plus 隔离技术及 BDTI 技术，有效提升像素满阱容量、量子效率及暗光成像性能。

在产品设计方面，公司自主研发了 COM 封装、COF-Like 设计及高像素单芯片集成等多项特色技术，在片内 ADC、数字电路及接口电路等方面形成较强技术积累。依托上述技术，公司已形成覆盖 1,300 万、3,200 万及 5,000 万像素的高像素 CIS 产品体系，2025 年 3,200 万及 5,000 万像素产品累计出货超过 1 亿颗，相关技术已得到规模化量产和市场验证。

综上，公司已具备较为完善的 CIS 工艺研发、产品设计及晶圆制造能力，相关核心技术已实现规模化产业应用，能够为本项目顺利实施提供良好的技术基础。

(3) 下游市场蓬勃发展，为本项目提供市场保障

得益于智能手机高像素及多摄升级、ADAS 及自动驾驶加速渗透、安防监控数字化升级、智能穿戴及 AR/VR 等新兴应用快速发展，CIS 下游市场前景广阔，推动 CIS 行业形成多元化的增长动力。

智能手机领域，IDC 数据显示，2025 年全球智能手机出货量达 12.60 亿部，同比增长 1.9%，高端机型向高像素、多摄方向升级，CIS 需求稳定上升。汽车电子领域，根据灼识咨询数据，2030 年中国 L1-L4 智能汽车出货量将增至 3,010 万辆，2024-2030 年 CAGR 约 11.1%，渗透率同步提升至 99.4%，车载摄像头搭载数量及性能要求将持续提高。安防监控领域，CPS 数据显示，2025 年中国安防行业总产值达 11,160 亿元，同比增长 4.3%，高清化、智能化趋势推动高性能 CIS 需求增长。智能穿戴领域，根据 Precedence Research 数据，全球智能穿戴设备市场规模将以 20% 的年均增速逐年上升，2034 年达到 4,317 亿美元；其中 AI 眼镜发展势头强劲，有望进一步带动低功耗、小型化、高性能 CIS 市场需求。

综上，下游应用持续拓展及产品规格升级将共同推动 CIS 市场增长，为本项目新增产能消化提供良好的市场基础，本项目实施具有可行性。

4、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为格科半导体（上海）有限公司。本项目总投资 613,200.74 万元，拟使用本次向特定对象发行股票募集资金投入 300,000.00 万元，预计建设周期为 3 年，主要用于设备购置等。本项目有助于提升公司核心竞争力、进一步

扩大业务规模，具有良好的经济效益。

5、项目涉及的审批、备案事项

本项目建设地点位于上海市临港产业区，公司已取得沪（2026）市字不动产权第 000441 号及沪（2026）市字不动产权第 000442 号不动产权证书。

本项目已于 2020 年 6 月完成项目备案手续（项目代码：2020-310115-39-03-003784，并于 2024 年 8 月完成第四次备案变更）；本项目已于 2025 年 12 月取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会出具的《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会关于 12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目（调整）环境影响报告表的审批意见》（沪自贸临港环保许评[2025]102 号）。

（二）高性能高像素图像传感器研发及产业化项目

1、项目基本情况

本项目总投资为 57,666.44 万元，建设期为 4 年。公司拟通过本项目，在现有图像传感器设计、特色工艺及晶圆级制造等技术基础上，重点开展 1 亿像素和 2 亿像素高性能 CMOS 图像传感器（CIS）产品的研发及产业化，主要面向中高端及旗舰智能手机，并拓展至口袋云台相机、运动相机、全景相机等非手机类高性能影像终端，布局单芯片、堆栈式和 3D 堆栈式等技术架构，持续推进产品设计、工艺开发、工程验证及量产导入，提升公司高端 CIS 产品的研发及产业化能力。

同时，本项目将围绕高像素 CIS 产品研发及产业化需求，建设高像素 CIS 共性技术平台，重点开展超小像素结构、高速读出电路、模拟及数字混合电路、高速接口、晶圆级堆栈、片上图像处理、存储控制、先进封装及可靠性验证等关键技术研发，并推进相关技术在具体产品中的开发验证和产业化应用，构建覆盖核心技术研发、产品设计、工艺开发、工程验证及量产导入等环节的研发及产业化体系。

项目建设完成后，公司将进一步完善高性能高像素 CIS 自主技术体系，增强

不同技术架构下高端 CIS 产品的持续研发、工程化验证及产业化能力，加快 1 亿像素、2 亿像素等高像素 CIS 产品的研发成果转化和市场应用，进一步丰富公司高端 CIS 产品布局，提升公司在高端图像传感器领域的技术实力和市场竞争力。

2、项目实施的必要性分析

(1) 本项目是顺应 CIS 高性能化及先进架构演进趋势，加快高性能高像素 CIS 研发及产业化的必要举措

CIS 具有技术迭代速度快、研发周期较长、设计与工艺协同程度高等特点，相关产品通常需要经过技术预研、方案设计、工艺开发、样品验证、工程化优化及量产导入等多个阶段，从核心技术形成到产品实现产业化应用具有较长的开发周期。随着智能手机和非手机类高性能影像终端对图像采集、感知及处理性能要求持续提升，CIS 正向更高像素、更高动态范围、更快读出速度、更低功耗及更强片上处理能力方向发展，技术架构亦由传统单芯片逐步向堆栈式、多层 3D 堆栈式等先进架构演进。特别是在 1 亿像素、2 亿像素等高像素产品中，像素尺寸、感光性能、动态范围、读出速度、功耗及芯片面积等指标之间的协同难度进一步提高，对企业持续研发、工程验证及产业化能力提出更高要求。

在此背景下，公司有必要紧跟高性能高像素 CIS 技术演进方向，提前开展核心技术研发与产品布局，并加快相关技术向产品化和产业化转化。本项目聚焦 1 亿像素和 2 亿像素高性能 CIS，重点布局单芯片、堆栈式和 3D 堆栈式三类技术架构，围绕超小像素、高速读出、高动态范围、晶圆级堆栈、多层集成及片上处理等关键方向开展技术研发、产品开发及工程验证，并推动相关产品实现产业化应用。通过本项目实施，公司能够进一步缩短核心技术从前期研发、工程验证到产品开发及市场导入的衔接周期，增强对 CIS 技术快速迭代和终端产品升级需求的响应能力。

(2) 本项目是建设高像素 CIS 共性技术平台，提升研发效率及成果转化能力的必要举措

高性能高像素 CIS 涉及像素设计、模拟及数字电路、高速接口、特色工艺、

晶圆级集成、图像处理、先进封装及可靠性验证等多个技术环节。单芯片、堆栈式和 3D 堆栈式 CIS 虽然在产品架构、技术复杂度和应用定位等方面存在差异，但在像素结构、电路设计、高速读出、接口技术、图像处理及可靠性验证等底层技术方面具有较强的共通性。若不同产品及技术路线分别独立开展研发，容易造成基础技术和研发资源相对分散，不利于核心技术模块及研发成果在不同产品之间的复用，也将增加后续产品持续升级和产业化开发的成本。

因此，公司有必要通过平台化方式对高像素 CIS 相关底层技术、核心模块及验证能力进行系统沉淀，形成能够支撑不同技术架构和不同产品持续开发的共性技术基础。本项目拟搭建高像素 CIS 共性技术平台，围绕超小像素结构、高速读出电路、模拟及数字混合电路、高速接口、晶圆级堆栈、片上图像处理、存储控制、先进封装及可靠性验证等方向开展研发，并形成可支持不同技术架构的核心技术模块和验证体系。

通过本项目实施，公司能够进一步加强不同产品及技术路线之间的技术共享和研发协同，提高核心技术及研发成果的复用程度，缩短后续产品设计、验证及工程化开发周期，并推动共性技术成果持续向单芯片、堆栈式及 3D 堆栈式高像素 CIS 产品转化，为公司高端 CIS 产品持续迭代及产业化提供基础支撑。

(3) 本项目是完善高端 CIS 产品布局，提升公司高端市场竞争能力的必要举措

随着智能手机影像功能持续升级，以及口袋云台相机、运动相机、全景相机等高性能影像终端应用不断发展，终端设备对高像素、高动态范围、高速对焦、高帧率视频及计算摄影等影像能力提出更高要求，推动 CIS 产品持续向更高像素、更高集成度及更先进架构方向演进。与此同时，高端 CIS 产品研发涉及像素设计、电路架构、特色工艺、晶圆级堆栈、片上图像处理及工程验证等多个环节，对企业综合技术积累和产业化能力提出较高要求。目前，全球高端 CIS 市场仍主要由国际头部厂商占据，先进堆栈、多层集成及片上处理等技术已成为高端及旗舰级 CIS 产品持续升级的重要方向。对于国内 CIS 厂商而言，持续加强高端产品研发及产业化能力，完善不同技术架构和性能层级的产品布局，是提升高端市场

竞争力的重要基础。

公司目前已在图像传感器设计、特色工艺、高像素单芯片集成及晶圆级制造等领域形成一定技术和产品基础。随着 CIS 产品进一步向高性能、高集成度和先进架构方向升级，公司需要在现有基础上持续拓展堆栈式、3D 堆栈式、片上图像处理、高速缓存及多层协同等技术及产品能力，实现由现有高像素产品向更高性能、更高集成度产品的持续延伸。

本项目将在公司现有高像素 CIS 技术及产品基础上，围绕不同市场定位布局单芯片、堆栈式和 3D 堆栈式高像素 CIS，持续推进 1 亿像素和 2 亿像素产品开发及产业化。通过本项目实施，公司将进一步丰富高端 CIS 产品矩阵，增强面向不同终端产品定位和性能需求的产品供给能力，加快高端 CIS 研发成果向产业化应用转化，不断提升公司在高端图像传感器领域的产品竞争力和市场竞争能力。

综上所述，本项目是公司顺应行业技术发展趋势的必要举措，有利于提升研发效率及成果转化能力，完善高端 CIS 产品布局，提升公司高端市场竞争能力。因此，本项目实施具有必要性。

3、项目实施的可行性分析

(1) 国家产业政策持续支持集成电路关键核心技术研发，为本项目提供政策保障

集成电路产业是信息技术产业的重要基础，也是国家重点支持发展的战略性、基础性和先导性产业。近年来，国家持续出台相关产业政策，从技术研发、人才培养、知识产权、投融资等多个方面支持集成电路产业发展，为行业持续开展技术创新营造了良好的政策环境。

《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》明确从研究开发、人才、知识产权、投融资等方面进一步优化集成电路产业发展环境；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出，全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关取得突破，提升高端芯片等产业发展水平。

高性能高像素 CIS 属于技术密集型集成电路产品，本项目拟围绕超小像素、高速读出、晶圆级堆栈、片上图像处理及存储等关键技术开展研发，与国家推动集成电路关键核心技术攻关、提升高端芯片自主创新能力的政策导向相契合。良好的产业政策环境有利于公司持续开展研发投入、加强人才队伍建设并完善研发平台，为本项目实施提供有利的外部条件。

（2）充足的专利储备与扎实的技术积累，为本项目提供核心保障

公司长期深耕 CMOS 图像传感器领域，形成了充足的专利储备与扎实的技术积累，为本项目进一步开展高性能高像素 CIS 相关技术研发奠定了基础。

专利储备方面，公司高度重视自主知识产权积累和核心技术保护，持续围绕 CMOS 图像传感器相关技术开展专利布局。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计获得国际专利授权 20 项、国内发明专利授权 373 项、国内实用新型专利 218 项，并累计获得软件著作权 20 项。持续的技术研发及知识产权积累，有助于公司形成自主可控的核心技术体系，并为本项目后续关键技术攻关提供技术储备。

技术积累方面，公司目前已形成覆盖 $0.61\ \mu\text{m}$ 、 $0.64\ \mu\text{m}$ 、 $0.7\ \mu\text{m}$ 、 $0.8\ \mu\text{m}$ 和 $1.0\ \mu\text{m}$ 等多种像素规格的高像素 CIS 技术基础，且创新的高像素单芯片集成技术已实现应用。公司在超小像素设计、像素工艺优化、高像素芯片架构及相关工程验证等方面积累的研发经验，可为本项目进一步开展堆栈式、3D 堆栈式 CIS 及片上图像处理、存储等更高复杂度技术研发提供基础支撑。

（3）专业的研发团队及丰富的研发经验，为本项目提供实施保障

高性能高像素 CIS 研发涉及像素器件、模拟电路、数字电路、图像处理算法、工艺整合、晶圆级堆栈、封装测试及可靠性验证等多个技术环节，具有较强的多学科交叉特征，对研发人员的专业能力、技术覆盖广度以及跨环节协同能力要求较高。因此，专业的研发团队及丰富的研发经验，是保障项目顺利实施的重要基础。

公司长期重视研发人才队伍建设，已建立规模较大、专业结构较为完善的研发团队。截至 2026 年 6 月 30 日，公司研发人员为 1,073 人，占员工总数的 44.84%，

其中硕士及以上学历人员占研发人员比例超过 57%。公司研发人员的专业背景可覆盖高性能高像素 CIS 涉及的各个研发环节，能够为本项目实施提供可靠的人才储备。

同时，公司围绕高像素 CIS、先进像素平台、低功耗、高动态范围及高速视频等方向持续开展研发活动，积累了较为丰富的研发实践经验和项目管理经验。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有在研项目 18 项，持续围绕核心产品及前沿技术方向开展研发投入。现有研发项目的持续推进，有助于公司进一步完善研发管理机制和跨部门协同体系，为本项目涉及的超小像素、高速读出、先进堆栈及片上处理等技术研发提供项目实施经验支持。

（4）良好的市场基础及客户积累，为本项目产业化提供市场保障

公司长期深耕 CMOS 图像传感器领域，主要产品已广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、汽车电子等终端领域，在 CIS 市场形成了较为良好的市场基础。2025 年，公司手机 CMOS 图像传感器出货量超过 11 亿颗，市场份额处于第一梯队，体现了公司较强的产品市场认可度及规模化销售能力。

在高像素 CIS 领域，公司近年来持续推进产品结构升级，已由低像素产品逐步拓展至 5,000 万像素主流市场。截至 2026 年 6 月，公司 5,000 万像素图像传感器累计出货量已超过 1 亿颗，并持续推进更高像素 CIS 技术及产品布局。现有高像素产品的规模化市场应用，使公司在产品定义、客户需求理解、产品验证及市场导入等方面积累了较为丰富的经验，为本项目进一步向 1 亿像素和 2 亿像素高性能 CIS 拓展奠定了良好的市场基础。

同时，公司长期服务于智能手机等消费电子市场，能够持续跟踪终端客户对图像传感器在像素规格、成像性能、功耗、芯片尺寸及成本等方面的需求变化，并依托现有市场和客户基础推动新产品验证及导入。本项目是在公司现有 CIS 业务和高像素产品基础上的进一步升级，有利于公司充分利用既有市场资源及客户合作基础，加快 1 亿像素、2 亿像素高性能 CIS 产品的市场导入和产业化应用。

综上，公司良好的市场基础、高像素 CIS 产品的规模化应用经验以及长期积

累的客户资源，为本项目后续产品验证、市场导入及产业化应用提供了良好的市场保障。本项目实施具有可行性。

4、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为格科微电子（上海）有限公司。本项目总投资 57,666.44 万元，拟使用本次向特定对象发行股票募集资金投入 50,000.00 万元，预计建设周期为 4 年，主要用于设备购置、研发人员薪酬、软件使用费用、试制费用等。本项目有助于进一步提升公司技术实力，具有良好的经济效益。

5、项目涉及的审批、备案事项

本项目将在格科微上海已租赁场地进行项目建设，不涉及土地取得情况。

截至本预案公告日，本项目的备案手续尚在办理过程中。公司将按照相关法律法规要求及时、合规办理。

（三）补充流动资金

1、项目基本情况

公司拟将本次募集资金中的 70,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司业务发展对营运资金的需求，优化资本结构，保障公司主营业务持续稳健发展。

2、项目实施的必要性分析

公司所处行业属于典型的资金、技术、人才密集型行业，行业经营特点与发展模式决定了企业的晶圆采购、周转，芯片研发、投产，人才招聘和培养，均需要大量资金投入。近年来，公司维持着较高的业务规模增速，日常运营对流动资金要求较高。公司 2023-2025 年营业收入年均复合增长率达 28.71%。结合公司持续增长的销售收入、不断扩大的业务规模，预计未来几年内公司仍将处于业务快速扩张阶段，对流动资金的需求也将进一步扩大。

本次补充流动资金将有利于保障公司业务规模的拓展、业务发展规划的顺利实施以及行业前沿技术研发布局，促进公司可持续发展。

3、项目实施的可行性分析

公司本次募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关要求，具有可行性。公司已建立完善的企业管理制度，形成了规范的公司治理体系和内部控制环境。在募集资金管理方面，公司已根据监管要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用等方面进行了明确规定。本次募集资金到位后，公司将严格遵守募集资金使用有关要求，确保本次募集资金的存放、使用和管理符合规范。

四、本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司为国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、制造、封测和销售。公司在CMOS图像传感器领域和显示驱动领域深耕多年，拥有业内领先的工艺研发和电路设计实力。

根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司从事的集成电路设计为战略性新兴产业，具体分类为：1 新一代信息技术产业-1.3 新兴软件和新型信息技术服务-1.3.4 新型信息技术服务（6520 集成电路设计），符合科创板行业领域要求；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于新一代信息技术领域企业，符合科创板行业领域要求。

本次募集资金投资项目包括 12 英寸 CIS 集成电路特色工艺扩产项目、高性能高像素图像传感器研发及产业化项目及补充流动资金，资金投向均紧密围绕公司主营业务。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域。

公司本次募集资金投向不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务。

（二）本次募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

本次募投项目的实施将促进公司科技创新水平的持续提升。其中，12 英寸

CIS 集成电路特色工艺扩产项目的实施将进一步完善公司 CIS 晶圆制造及关键工艺布局，有利于提升高端 CIS 关键制造环节的国产化水平，增强公司供应链保障能力及产业链协同能力，加快新产品产业化进程，推动产品结构持续优化，增强公司市场竞争能力；高性能高像素图像传感器研发及产业化项目的实施将提升公司研发效率及成果转化能力，完善高端 CIS 产品布局，提升公司高端市场竞争能力；补充流动资金将投入公司的主营业务运营，支持公司科技创新水平的持续提升。

综上所述，本次募投项目将强化公司科创属性，促进公司科技创新水平的持续提升。

五、结论

综上所述，公司认为：本次募集资金投向属于科技创新领域，符合未来公司整体发展方向，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。

格科微有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日